

# POP专用底部填充胶水WE-3008

产品名称	POP专用底部填充胶水WE-3008
公司名称	深圳市力邦泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山大道深意工业大厦516
联系电话	86-75588864001 13600411559

## 产品详情

韩国元化学（won chemical）公司推出的we-3008底部填充胶水尤其适用于pop叠层封装用途，其适中的粘度及流变特性保证了两层封装的锡球均得到有效的填充的保护。此型号产品已经在韩国本土三星、lg等公司得到了批量应用。

we-3008是一款单组分热固化可返修型underfill胶水，适用于bga、csp、pop等多种形式之封装芯片之底部填充功能，使用该胶水后产品具有更高的可靠性，耐冲击性能及耐冷热循环的能力。

该产品基本参数如下：

化学类型：环氧改性

外观：浅黄或黑色

固化条件：热固化5~20分钟@120~150度

典型应用：底部填充，微小元件固定及补强

返修性能：优越的返修性能

详细技术参数请咨询代理商newbonder索取tds&msds资料

韩国元株式会社 won chemical主要从事开发和生产电器电子产业中广泛使用的环氧树脂（epoxy）绝缘 mold材料，黏合剂以及epoxy modified uv 硬化型树脂。我们以绝缘材料领域积累的经验和技术为基础，积极应对电器电子行业的高功能化发展趋势引起的技术变化。同时我们对我们的核心产品不断进行质量改善和提高，改变本行业以前全部依靠进口的局面。我们在开发研制 smd 黏合剂、bga/csp用悬浮式密封（floating type channel seal）树脂、underfill环氧树脂，led封装树脂，清洁化合物（clear compound）和cob树脂等方面倾注精力。今后我们将以我们产品的质量和价格竞争力，成为电器电子产业的发展的主力，不断进行开发研制，使我们成为最有竞争力企业。